

# 設備作業標準

## ( SE-027 晶圓減薄研磨設備)

標準作業程序：

1. 刷卡開機。
  2. 於機台載台上放置晶圓
  3. 踏下腳踏開關
  4. 檢查操作側的 VACCUM 是否有-80kpa 以上
  5. 選擇晶圓研磨 - 選擇有精修研磨
  6. 畫面會跳出輸入 Recipe No.，選擇 1 按下確認
  7. 設定目標厚度
  8. 確認目標厚度是否正確
  9. 確認無誤後按下啟動按鍵
  10. 研磨完成結束後選擇晶圓更換與手動踩踏腳踏開關後即可取下晶圓
  11. 刷卡關機。
-